



「バックホウ+α」で実現する ICT 中層混合処理

ダイナWミキシング工法

日時：2024年5月22日(水)～5月24日(金)

会場：幕張メッセ

ブース番号：18-42 (展示ホール6)

日邦電機 ※サン・エンジニアとの共同ブース

ダイナWミキシング工法 とは

- ・バックホウに攪拌アタッチメントを接続するだけで、**中層混合処理**ができます
深度0.5～5.0m : バイブロ・バケット型 (VB)
深度3.0～10.0m : ショート・トレンチャ型 (ST)
- ・ICT管理装置 (マルチGNSS) により、施工状況を3D数値データ管理します
ガイダンス機能等により、**初心者オペが即戦力**になります
リアルタイムログデータが、**ベテランの勘を補助し高品質化**します
施工状況が見える化し、**施工管理者の負担が減少**します



(特許取得済)



(特許出願中)

